

奇景光電宣布推出低耗電的QVGA CMOS影像感測晶片

【台南，2016年1月19日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）子公司恆景科技（Himax Imaging, Ltd.）今天宣布，已成功開發出低耗電的QVGA CMOS影像感測晶片HM01B0（以下簡稱「HM01B0晶片」），它在擷取每秒30張QVGA影像時耗電僅小於2mW，而在每秒30張QQGA時更是小於0.7mW，另外還提供不同操作模式以達到更低的耗電量，預計在今年第一季，奇景將開始供應HM01B0晶片樣品給特定的客戶及夥伴。

奇景的HM01B0晶片，可持續提供情況感知及電腦視覺能力，給包括特徵萃取、靠近感知、手勢辨識、物體追蹤與圖像識別等應用，HM01B0晶片獨特的低耗電架構是提供給這類應用系統的整合者及開發者在影像解晰度、擷取速度、影像品質與耗電之間的最佳選擇。

HM01B0晶片整合了動作偵測功能，可在偵測到影像變化時提供中斷訊號給系統，同時也供自動曝光與增益控制的機制，以減少系統端處理器的運算及資料交換，以達到降低整體系統耗電的目的。而3.6 μ m的畫素可提供低至1 lux照度下仍可運作的感光靈敏度，可減少系統對外加LED或其他輔助光源的需求。另外，HM01B0晶片封裝大小僅不到5mm²，配合外加只需要3個被動元件即可運作，客戶可以設計出最小的模組尺寸，或是搭配奇景所提供的晶圓級光學鏡頭模組，使模組可輕易的與下一世代的低耗電環境感知與電腦視覺應用做結合。

奇景光電執行長吳炳昌表示，我們所生產給筆記型電腦或手機所使用的CMOS影像感測器，像是1/4英吋的8百萬畫素產品，就一直是業界耗電最低的。基於這樣的核心能力，奇景將開發一系列超低耗電但仍保持優秀影像品質及功能的影像感測器給電腦視覺的相關應用，包括智慧型手機、平板電腦、虛擬實境與擴增實境的設備、物聯網，以及其他有人工智能判斷的消費性產品與醫療或工業用產品。奇景已經與業界領先的消費電子品牌及主要平台供應商合作導入這種超低耗電的影像感測器，亦同時獲得不少產業領導廠商的熱烈反應。

奇景相信，HM01B0晶片是在可提供給成長中低耗電的電腦視覺相關市場中最好的解決方案，可廣泛的使用於行動裝置、虛擬實境與擴增實境的設備、物聯網，以及其他有人工智能判斷的相關應用。奇景將同時提供HM01B0黑白及彩色的兩種版本，預計在今年第一季，奇景將開始供應晶圓級光學鏡頭模組給特定的客戶及夥伴。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括 CMOS 影像感測 IC 及晶圓級鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全及醫療器材等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約 1,900 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至 2015 年 12 月 31 日為止，奇景光電在全球已取得 2,764 項專利，尚有 566 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
媒體關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

陳荻雅 / Nadiya Chen
投資人關係 經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
nadiya_chen@himax.com.tw

林佳慧 / Penny Lin
投資人關係 經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22320
penny_lin@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative
John Mattio, Founder
Lamnia International, LLC.
+1 (203) 885 -1098
Direct: +1 (203) 885 -1058
jmattio@lamnaintl.com
www.lamnaintl.com

風險說明:

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2014 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。